

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

峰昭科技（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表

2023 年 12 月 7 日

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国泰基金 广发证券
时间	2023 年 12 月 7 日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：BI LEI 董事会秘书：黄丹红 证券事务代表：焦倩倩
投资者关系活动 主要内容	<p>本次交流内容汇总如下：</p> <p>1、 公司自主知识产权的电机驱动控制专用内核及控制架构算法情况</p> <p>公司从底层架构上将芯片设计、电机驱动架构、电机技术三者有效融合，用算法硬件化的技术路径在芯片架构层面实现复杂的电机驱动控制算法，形成自主知识产权的电机驱动控制处理器内核，不受 ARM 授权体系的制约，并在芯片电路设计层面在单芯片上全集成或部分集成 LDO、运放、预驱、MOS 等器件，最终设计出的电机驱动控制专用芯片产品具备高集成度、能实现高效率、低噪音控制且能完成复杂控制任务，持续满足下游领域不断变化的应用需求。</p> <p>2、 公司下游应用领域情况</p> <p>公司持续深耕电机驱动控制专用芯片领域，专注于 BLDC 电机应用，产品广泛应用于智能小家电、白色家电、散热风扇、电动工具、运动出行、工业与</p>

汽车等领域。面对汽车电子领域的高可靠性要求、高门槛，公司从体系建设、研发攻关、系统级服务等方面着手，全面深耕汽车电子市场。2023 年公司通过 ISO 26262 功能安全管理体系认证，成为公司车规级芯片发展的重要里程碑。在市场拓展上，汽车电子领域的验证周期长，公司以系统级技术支持积极推动芯片产品在汽车电子领域从小批量试产逐步进入量产。

公司将继续根据终端市场需求，发挥公司在 BLDC 电机驱动控制领域的技术优势，积极探索下游 BLDC 电机新应用的可能性，提供更多符合下游电机控制需求的芯片产品与系统级解决方案，不断扩展终端应用领域与客户覆盖范围，持续提升公司在高性能电机驱动控制专用芯片这一细分领域的竞争力与市场地位。

3、公司研发团队和人才建设情况

公司核心技术团队分为芯片设计团队、电机驱动架构团队和电机技术团队。芯片设计团队由公司首席执行官 BILEI（毕磊）担任技术牵头人；电机驱动架构团队由新加坡国立大学博士、公司首席系统架构官 SOH CHENG SU（苏清赐）博士担任技术牵头人；电机技术团队由公司首席技术官 BI CHAO（毕超）博士担任技术牵头人。公司在芯片技术、电机驱动架构、电机技术三个领域均拥有核心优势，并且积累了丰富的研发成果。

公司高度重视人才培养和研发团队建设，坚持“自主培养、导师制、项目制”的人才培养战略，坚持内部培养、自主培养，建设技术精尖、富有创新活力的人才团队。

4、公司未来发展战略

公司将技术研发作为企业发展的重要战略举措，坚持走自主创新的研发之路，在电机驱动控制芯片设计、电机驱动控制架构算法、电机技术三个领域持续深耕，根据智能家电、汽车电子、工业等应用领域的新需求、新变化，开展技术研发，用创新的技术实现高性能的产品，以优异的技术和产品性能推动产品在下游应用领域的深入。

智能家电、汽车电子、工业等是公司产品未来发展的重要应用领域，公司将持续深耕智能家电市场，促进芯片产品进一步深入下游应用，巩固和提升在该领域的竞争优势，同时积极开拓汽车电子、工业等新兴应用市场，稳步推进

产品在新兴领域的应用。此外，海外市场拓展也是实现公司战略目标的重要一环，公司将继续推进海外市场布局，拓宽海外市场渠道，发展海外合作伙伴，组建高效技术团队即时响应海外市场需求，推动产品和技术在海外市场的应用推广。

未来公司将持续加大研发投入、深耕电机驱动控制芯片领域，将围绕着战略目标展开布局，从技术攻关、市场拓展、人才培养等方面着手，推进一系列举措，不断优化经营管理，创造充满活力、创新氛围强的经营环境，促进企业战略目标的实现。